

证券代码：300223

证券简称：北京君正

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20250303

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他（_____）</div></div>
参与单位名称及人员姓名	中信电子：程子盈；中金资管：陈俊；建信基金：陈韶晖；华商基金：康译丹等。
时间	2025 年 3 月 3 日
方式	现场交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	<div><div>一、公司基本情况介绍</div><div>二、问答环节</div><div>1、DRAM 的新工艺情况？ 工艺上，21nm 和 20nm 都有在研，预计今年可向客户提供样品，后续还会继续进行更新工艺的产品研发。</div><div>2、公司的 SOC 芯片上集成了哪些模块？ 公司的 SOC 芯片集成了公司自研的关键模块，包括 CPU、VPU、NPU、ISP 等，不同计算芯片产品有不同的配置。</div><div>3、代工厂都有哪些？ 计算芯片在格罗方德和台积电，DRAM 在力晶，SRAM 在中芯国际和华力，FLASH 在武汉新芯。</div><div>4、DRAM 中销售占比最大的是哪个产品？ 目前销量最高的是 DDR3 类的产品。</div><div>5、存储的价格？</div></div>

	<p>存储的价格会有变动，但主要面向的是汽车等行业市场，毛利率相对比较稳定。</p> <p>6、公司是否有关注 AI DRAM?</p> <p>公司有关注，我们认为这类产品有很好的市场空间，公司也在跟进 3D DRAM 产品。</p> <p>7、眼镜产品目前进展如何?</p> <p>目前这类产品使用的 T 系列芯片，有一些客户在研发中，有的客户已经发布了产品，还有一些客户在评估阶段，我们会持续跟进和支持这个市场方向。</p> <p>8、计算芯片情况?</p> <p>计算芯片主要面向消费类市场，其中 80%以上面向安防监控类产品，主要是民用的摄像头类产品，其余的市场种类比较多，包括二维码设备、生物识别、教育电子、智能门锁、打印机等，目前最新工艺是 12nm 的。</p> <p>9、公司模拟产品有哪些?</p> <p>模拟产品主要是 LED DRIVER，其中 50%以上是在汽车领域，其他在办公设备、工业级产品、白色家电、部分消费类产品等。</p> <p>10、公司各产品线在国内的销售情况?</p> <p>计算芯片大部分客户是国内客户，存储芯片 20%多的收入来自国内客户，模拟芯片大概 50%多的收入来自国内客户。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 3 月 3 日